

证券代码：301312

证券简称：智立方

深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会(2023 年度业绩说明会) <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 29 日 15:00-15:40
地点	进门财经（电话会议和网络文字互动形式召开）
上市公司接待人员姓名	董事长：邱鹏 董事会秘书兼财务负责人：廖新江 证券事务代表兼法务负责人：苏晓倩 保荐代表人：民生证券股份有限公司 秦亚中 独立董事：肖幼美、张淑钿、杜建铭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会通过电话会议和网络文字互动形式对公司 2023 年度经营、战略、财务情况进行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。</p> <p>一、2023 年度经营、战略情况介绍</p> <p>1. 主营业务介绍：</p> <p>公司属于高端装备制造行业，是一家专注于工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务的国家级高新技术企业，为下游客户智能制造系统、精益和自动化生产体系提供定制化专业解决方案，产品包括工业自动化设备、自动化设备配</p>

件及相关技术服务。

公司核心业务分为电子产品赛道、半导体赛道，其中电子产品赛道包括自动化测试设备及自动化组装设备业务，主要应用于消费电子、雾化电子、汽车电子等领域客户产品的光学、电学、力学等功能测试环节以及产品组装环节。公司产品线向半导体赛道的自动化设备需求方向进行延伸、拓展和覆盖，公司持续关注全球显示半导体、光通半导体、CMOS 半导体等领域设备，同时致力于以高端智能装备核心技术助力我国半导体关键设备国产化发展，以公司自主研发的 Mini LED/Micro LED 芯片分选机、AOI 设备、光通讯芯片排靶设备、固晶机等智能制造装备加快半导体设备的进口替代。公司在半导体设备领域已具有较强的市场竞争力及较高的品牌知名度，增长潜力巨大，半导体设备客户导入顺利，受到业内认可。

公司深耕行业多年，凭借优质的产品质量、高效的生产能力、良好的研发实力及优质的售后服务，与下游相关行业的多家国际知名企业保持长期稳定的合作，其中包括苹果公司、Meta、歌尔股份、鸿海集团、立讯精密、舜宇集团、捷普集团、广达集团、普瑞姆集团、乾照光电、兆驰股份、华灿光电等全球知名电子产品智能制造商。

2. 经营战略分析：

公司电子产品赛道核心业务为自动化测试、组装设备业务，产品覆盖光学、电学、力学等功能测试领域，并依托核心业务的技术和经验积极向自动化组装设备业务领域横向延伸、拓展和覆盖，主要应用于消费电子、雾化电子、汽车电子等领域。

公司半导体赛道主要为晶圆及芯片制造企业、半导体封装企业等提供设备，目前公司主要销售产品为分选机、AOI 设备、精密贴装设备等。凭借自主知识产权、相关核心技术，以公司为代表的半导体设备优势企业产品已成功进入相关龙头企业供应链体系。

3. 财务情况回顾：

2023 年度，公司实现营业收入 42,738.67 万元，同比下降 15.90%，归属于上市公司股东的净利润 7,256.67 万元，同比下降 37.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,090.06 万元，同比下降 52.86%，经营活动产生的现金流量净额为 1.29 亿元，同比增长 39.55%。公司基本每股收益为 1.16 元/股，加权平均净资产收益率为 6.07%。

公司作为国家级高新技术企业，重视研发投入，2021 年至 2023 年研发费用分别为 4,581.54 万元、4,826.71 万元和 5,425.99 万元，占当期营业收入比例分别为 8.35%、9.50%和

12.70%，研发投入保持上升趋势。

二、主要问答环节

1. 请公司简述消费电子自动化设备行业景气度情况以及是否存在对业务结构的调整？

回复：消费电子下游需求不振，3C 设备短期景气度承压，但行业长线成长逻辑及国产替代趋势依旧清晰。公司 2023 年业务结果本质是原有业务(第一增长曲线)在电子产品检测和组装赛道不及预期，同时在新业务(第二增长曲线)半导体赛道的增长还不能够达到支撑整个集团向上的叠加结果。公司将充分依托自动化设备领域积累的核心技术与经验，以原有优势领域（电子产品赛道）为切入口，把握半导体赛道快速发展带来的战略机遇，立足于显示半导体、光芯片等现有领域，向更多半导体应用场景延伸。

2. 请公司简述切入电子产品大客户的契机。

回复：公司最早开始接触大客户是在 2014 年至 2015 年期间，大客户对自动化设备有爆发式需求。经过大客户严格、复杂、长期的供应商认证，公司自设计研发阶段已经充分介入。此后，公司凭借多年的自动化设备行业技术及经验积累，融合大客户的产品设计特点与测试性能需求，形成较强的客户粘性。同时出于供应链的安全性及稳定性考虑，大客户也不会轻易更换自动化设备的供应商。

3. 请公司更新在 MR 领域的设备进展及相关行业的展望。

回复：受限于严格的保密协议，公司不便针对客户产品具体情况发表评论，在新产品、新业务方面，公司充分肯定人机交互、虚拟现实等产业未来在工业、交通、医疗、娱乐等不同领域的发展空间。公司将密切跟踪客户对 MR 设备的需求，保持与客户的技术交流和沟通。

4. 请公司简述技术服务情况。

回复：公司有部分海外大客户，因产品研发在欧美，生产在亚太，他们对技术人才有一定的需求。公司经过多年发展完成了从人才到技术的积累，构建了成熟的研发体系，具备快速

响应客户需求、及时提供技术服务的能力。公司凭借专业的技术服务团队，主要为客户提供全天候产品维保服务、产线运维服务和项目管理服务等。

5. 公司业务从消费电子向半导体设备拓展，请简述半导体领域主要产品及客户情况。

回复：公司依托深厚的研发实力及持续的技术创新，已在半导体设备领域取得初步的市场份额。在显示类半导体领域，产品包括分选机设备、AOI设备，公司客户包括兆驰股份、乾照光电、华灿光电等行业头部企业。在光芯片领域，产品包括激光芯片贴附设备、AOI设备，公司客户包括度巨核芯光电技术(苏州)有限公司、海思光电子有限公司、苏州长光华芯光电技术股份有限公司等。公司依据设备研发技术难度从低到高，市场需求从大到小原则，兼顾客户开发优先老客户新客户，产品推广优先老客户新产品，向上下游、新工艺、海内外市场拓展，有望在半导体芯片及封装设备领域进一步开拓市场。

6. 请公司简述显示半导体、光芯片领域设备的最新进展。

回复：公司显示半导体、光芯片领域的芯片分选机设备已成功进入相关龙头企业供应链体系，目前持续出货中，Q2的需求及销售有望突破新高。同时公司以半导体相关设备的国际技术动态、客户需求为导向，持续深入研发，推出了图像传感领域的芯片分选检测设备、半导体封装环节的高精密固晶设备，目前处于客户验证阶段，预计下半年批量销售。

7. 请公司简述汽车电子业务进展。

回复：公司产品可应用在声控、视觉及显示领域，包括声控类的汽车音响测试设备、视觉类的汽车摄像头生产设备、抬头显示 HUD 生产设备等。公司将紧抓当前的产业发展机遇，充分发挥公司汽车电子产品的定制开发能力，适时拓展相关应用场景，制定和完善前瞻性布局 and 规划。

8. 请公司简述新型雾化电子业务进展。

回复：公司在新型雾化电子行业的业务系为电子烟终端品牌商及其代工厂商的产品生产线提供精密组装自动化线及功能测试设备。在公司技术及研发团队的不断努力下，公司新型雾化电子相关技术及方案得到进一步完善。目前公司已对

接多家头部客户，将稳健扩大新型雾化电子产品份额，充分发挥技术优势和供应链的协同效应，提升公司在新型雾化电子领域的竞争优势。

9. 公司 2023 年净利润下降，且 2024 年第一季度发生亏损，受哪些因素影响？

回复：公司毛利率、净利率下降主要受宏观经济下行、消费电子行业周期波动引发下游产业需求收缩、半导体设备验收周期长等多方面因素影响。

10. 请公司简述合资公司（深圳施耐博格）的发展情况。

回复：公司的参股子公司深圳施耐博格，为亚太区域内提供从设计、研发、生产、制造到销售的一站式服务。该公司依托智立方在自动化测试与组装行业的丰富客户基础、尖端研发实力及深入行业经验，与全球顶级的运动控制平台供应商——瑞士施耐博格(SCHNEEBERGER AG Lineartechnik)合作。通过引进瑞士施耐博格领先的线性运动技术和矿物铸造知识，不断拓宽公司在半导体、光学量测、超精密激光加工、医疗技术等领域的发展前景。目前部分产品进入样机生产阶段，预计 2024 年实现量产。

11. 请公司简述海外布局情况。

回复：公司的海外策略是多方位、多层次的国际化布局，旨在通过跟随现有客户、深化海外子公司、办事处的本地化运营以实现全球市场的持续增长和品牌影响力的提升。

12. 请公司立足业务增长点，简述 2024 年的业绩展望。

回复：首先，公司将持续强化第一增长曲线（电子产品），巩固、提升在消费电子、汽车电子、新型雾化电子等赛道的布局、客户和解决方案。其次，加速第二增长曲线（半导体），持续地、坚定地加速研发投入和新产品开发，目前公司已在显示半导体(Mini-LED、Micro-LED)、光芯片等细分赛道打开市场缺口并取得行业认可。最后，公司将不断思考、探索和培育新的业务增长点。和百年企业瑞士施耐博格(SCHNEEBERGER AG Lineartechnik)的合资公司让智立方引

	<p>进了最前沿的技术并有机会进军超精密应用市场。</p> <p style="text-align: center;">13. 请问公司是否有融资计划？</p> <p>回复：公司现有充足资金支持现有业务的深耕以及新业务的扩张，短期内未有融资考虑，后续将根据业务进展、战略规划和融资环境，在合适的时点进行融资安排。</p> <p style="text-align: center;">14. 请公司简述后续分红计划及考虑。</p> <p>回复：公司 2023 年年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司重视投资者的收益和回报，在兼顾公司发展和业务开拓的基础上，公司希望加大分红力度与频次，与投资者持续共享收益，敬请关注后续信息披露情况。</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 29 日